

证券代码：301095

证券简称：广立微

杭州广立微电子股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2023-007

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容） <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input checked="" type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 线上交流
活动参与人员	华安基金、工银瑞信、招商基金、广发基金、东方红资管、华泰保险资管、南方基金、富国基金、中欧基金、银华基金、华夏基金、汇丰晋信、平安养老保险、新华资产、易方达基金、泰康资产、信达澳亚、北大方正人寿、长盛基金、圆信永丰、海富通、建信养老、常春藤资产、泰康基金、宝盈基金、博时基金、百年保险资管、华夏久盈、天弘基金、民生证券、浙商证券、中邮证券、中信建投共 33 家机构。
时间	2023 年 8 月 31 日-2023 年 9 月 12 日
地点	公司会议室
形式	现场会议、线上交流
公司接待人员	董秘兼财务总监：陆春龙 证券事务代表：李莉莉
交流内容及具体问答记录	一、公司概述 广立微是领先的集成电路 EDA 软件与晶圆级电性测试设备供应商，公司专注于芯片成品率提升和电性测试快速监控技术，是国内外多家大型集成电路制造与设计企业的重要合作伙伴。公司现已形成 EDA 设计软件、WAT 测试设备及半

导体数据分析工具相结合的成品率提升全流程解决方案，在集成电路从设计到量产的整个产品周期内实现芯片性能、成品率、稳定性的提升。

二、问答环节

1、请公司简要介绍 2023 年上半年的财务数据以及业绩构成。

2023 年上半年受到全球经济前景不确定性、下游消费市场创新力不足等因素的影响，全球半导体行业需求处于下行周期。公司通过持续创新不断拓展产品应用广度和深度，推出具有市场竞争力的产品，在业绩上仍然呈现出快速增长的趋势。2023 年上半年公司业绩营收 12,737.53 万元，同比增长 63.91%。在业绩构成上，公司软件业务收入 3,242.39 万元，同比增长 16.20%，稳步增长（软件业务中的软件工具授权业务占比 68.94%，同比增长 57.77%）；硬件业务收入 9,478.35 万元，验收 19 台 WAT 设备，同比增长 90.54%。从净利润角度，公司上半年实现归母净利润 2,284.31 万元（未剔除股份支付部分 809.88 万元），同比增长 3903.60%；扣非净利润 1,623.79 万元，同比增长 327.15%。

2、请公司简要说明促进公司业绩持续快速增长的因素包括哪些？

公司广立微始终秉承技术创新的发展理念为客户不断创造价值，不断加深与现有客户的合作深度，并不断扩展新客户，在 EDA 软件方面，客户端保持较高的复购率和增购率，并在不断扩展新客户；另一方面，公司的 WAT 测试设备经过在几家典型客户处验证成功后，业务推广顺利并已经规模化进入晶圆厂量产线，设备销量和市场占有率逐年提升。公司在业务发展和规划上定位清晰，持续加大研发投入力度，在软件上围绕成品率提升业务、利用软硬件协同的优势加深工

艺监控方案的研发和推广，同时不断开拓新品类的软硬件产品，陆续发布了第一款可制造性设计工具——化学机械抛光（CMP）建模软件、半导体缺陷自动分类系统、升级版 WAT 测试设备（T4000 型号）等，这些产品不仅能够丰富完善公司的集成电路成品率提升系统性解决方案，未来也能够为公司的业务收入增长提供多点引擎。

3、请公司简要介绍上半年度在 EDA 软件方面的研发和技术进展。

公司 EDA 软件产品主要聚焦于制造类 EDA。报告期内，公司积极深化测试芯片相关 EDA 软件产品的技术研发，迭代出支持更多应用场景的功能模块，拓宽产品的应用场景并扩展推出了多款软件产品：

- 发挥软硬件协同的竞争优势，将公司的测试芯片相关 EDA 设计工具应用到量产阶段，推出先进的工艺过程监控（PCM）方案，打通设计、测试和分析工具的整合平台，提供高效率解决方案，支持高质量的稳定量产，目前该方案已经在多家产线验证优化；
- 拓展布局可制造性（Design for Manufacture, DFM）系列 EDA 软件，自主开发了化学机械抛光工艺的建模工具 CMP EXPLORER，解决集成电路设计、制造过程中 CMP 工艺的行业痛点，保障芯片的可制造性和良率，目前软件正在晶圆厂试用导入中；
- 持续延伸布局半导体数据分析与管理系统（DATAEXP 系列产品），其中半导体通用化分析工具 DE-G、集成电路良率分析与管理系统 DE-YMS、集成电路缺陷管理系统 DE-DMS、缺陷自动分类系统（DE-ADC）等产品已研发成熟并进入市场拓展和商务落地阶段，半导体设备异常监控及分类系统 DE-FDC 产品已完成初版并已引入客户进

行试用中；同时，公司持续深入挖掘 AI 技术并使其在数据系统中发挥重要价值, 举例来说，公司使用基于前沿的 AI 视觉技术研发 DE-ADC 系统，该系统具备晶圆缺陷高分类精度和快速部署能力，并能与 DE-DMS 深度配合，拥有持续学习的能力，目前系统已经在多家集成电路企业部署使用并受到客户的一致好评。

4、请公司简要介绍上半年度在电性测试设备方面的研发和技术进展。

在电性测试设备方面，公司不断精进测试技术、扩展产品品类。2023 年上半年优化升级并推出了新一代通用型高性能半导体参数测试设备(T4000 型号), 可覆盖 LOGIC, CIS, DRAM, SRAM, FLASH, BCD 等所有产品的测试需求，支持第三代化合物半导体（SiC/GaN）的参数测试，测试效率有效提升，具有很高的性价比，适合应用于对成本比较敏感的 8 英寸以下及化合物半导体产线。同时，在 T4000 电性测试设备的基础上协同开发了可靠性测试分析系统（Wafer Level Reliability, WLR）等功能，将设备从 WAT 测试扩展至 WLR 及 SPICE 等领域。在 T4000 系列测试设备中，公司通过与国内合作伙伴合作开发的方式开发出新一代超低漏电可扩展矩阵开关，具备精度高、速度快、灵活配置的优良特性，降低了硬件设备的材料成本，提升产品性能和性价比，进一步增强了产品的竞争力。

5、公司在公告中披露了员工激励计划草案，能否简要介绍该计划的相关情况？

股权激励作为公司现代化管理的重要举措，能够进一步建立、健全公司长效激励与约束机制，吸引和留住优秀人才，并充分调动公司员工的工作积极性，有效地将股东、公司和核心团队个人利益结合在一起形成利益共同体，增强公司整

	<p>体凝聚力。公司近年来一直保持着高研发投入力度，人员规模增长迅速，以今年上半年为例，6月末公司人员总数402人，其中研发人员为327人，较上年同期增长84.75%，在这些人员中有很多优秀的技术和核心管理人员，因此公司拟定了此次员工股权激励计划。在该计划中，公司充分统筹考虑，拟向激励对象授予的限制性股票总量为120.00万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额20,000.00万股的0.60%。其中，首次向本次87名被激励对象授予98.70万股，占本激励计划拟授予权益总数的82.25%，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的0.49%；预留21.30万股，占本激励计划拟授予权益总数的17.75%，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的0.11%；同时，公司经过充分统筹考虑，对本次限制性股票做了公司业绩考核、个人绩效考核等方面的归属条件要求，具体详情请可以参考公司在巨潮资讯网发布的公告文件。谢谢！</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>无。</p>
<p>活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有，可作为附件）</p>	<p>无。</p>
<p>日期</p>	<p>2023年9月12日</p>